

【原因、判断要点、发生工序】元件封装的焊料在冷却时，热应力不平衡而引起的（元件封装工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by an imbalance of thermal stress imposed during the cooling of solder in component mounting (Component mounting process)



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 × 40

【注釋】
截面
顕微鏡倍率 × 40

【Comments】
Microsection
Magnification: ×40

10-1-8 ランド変形／通焊環変形 / Deformed land

【特徴】スルーホールランドが電子部品リード線に圧縮されたように変形している状態の欠陥

【特征】焊環被元件引脚压缩而变形的缺陷。

【Characteristics】The land of a PTH is deformed looking like pressed by a component lead.

【起因・判断ポイント・発生工程】電子部品実装はんだが冷却する際の熱ストレスのアンバランスによりリード線に押されて出来たもの（電子部品実装工程）

【原因、判断要点、发生工序】元件封装的焊料在冷却时，由于热应力不平衡引脚被挤压而引起的（元件封装工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The land of a PTH is pressed by a component lead due to an imbalance of thermal stress imposed during the cooling of solder in component mounting (Component mounting process)



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 × 200

【注釋】
截面
顕微鏡倍率 × 200

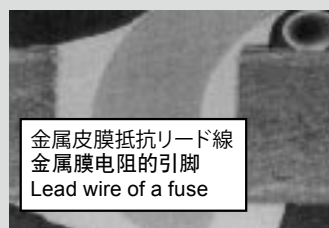
【Comments】
Microsection
Magnification: ×200



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
截面
顕微鏡倍率 ×

【Comments】
Microsection
Magnification: ×

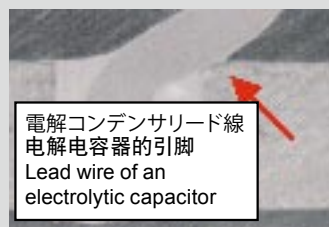


金属皮膜抵抗リード線
金属膜电阻的引脚
Lead wire of a fuse

【コメント】
断面
顕微鏡倍率 × 200

【注釋】
截面
顕微鏡倍率 × 200

【Comments】
Microsection
Magnification: ×200



電解コンデンサリード線
电解电容器的引脚
Lead wire of an electrolytic capacitor

【コメント】
断面
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
截面
顕微鏡倍率 ×

【Comments】
Microsection
Magnification: ×